

INHALT

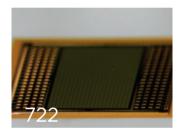
Juni 2024

685

Anlässlich der Konferenz "Electronics Goes Green' im Juni widmen wir uns dem Thema Green Design für die Elektronikfertigung



Unser Messespezial: SMTconnect, PCIM Europe und Sensor+Test im Fokus



Chipbonden ermöglicht die Montage auf Oberflächen mit unterschiedlichen Eigenschaften



Ein neues Ätzverfahren könnte Elektronik und Photonik auf einem Chip vereinen

Eine	be	S

EDITORIAL

ondere Messe 641

AKTUELLES

NEWS & Trends 645 SMTconnect - PCIM Europe - Sensor+Test 655 **TERMINE & Events** 666

BAUELEMENTE

669 Treibende Kraft für Elektronikfertigung in Europa embedded world 2024 674



DESIGN

Green Design bei Power Modulen für PC und Gaming 685



LEITERPLATTENTECHNIK

Kolumne: "Auf den Punkt gebracht" (H. J. Friedrichkeit) Wer ist Marktführer, wer Verfolger?

Im Rückspiegel: Das war die Lounges 2024

696 704

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Von der Idee bis hin zur Realisierung

718

Chip-Montagemöglichkeiten

in der Aufbau- und Verbindungstechnik

722



ANALYTIK & TEST

Meilenstein

in der Sensorik

733



Nachbericht zur Fachmesse "Lounges 2024" in Karlsruhe über Reinraumtechnik



Angeschoben durch Großinvestitionen bahnt sich eine Renaissance der europäischen Mikroelektronik ab - mit dem Wachstumskern Sachsen

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Mit integriertem Licht zu den Computern der Zukunft 738

FORUM

"Was TSMC jetzt hier investiert, kommt zehnfach zurück" 741
Hannover-Messe: Technologie trifft Optimismus 747
Kolumne 'Anders Gesehen' (Prof. Armin Rahn)
Aus Eins mach' Zehn 749



Qualitativ hochwertige Basismaterialien und Prepregs

Flexible, zuverlässige Supply-Chain-Lösungen





Hexenzirkel bestehen idealer Weise aus 13 Teilnehmerinnen - in der Leiterplattenproduktion bestehen Panels ebenfalls aus mehreren PCBs

FORUM

PLUS-Firmenverzeichnis	609
Im Heft redaktionell erwähnte Unternehmen	635
Kleinanzeigen	637
Inserentenindex	637
Mediadaten	638
Impressum	639
Gespäch des Monats: Lisette Hausser. Vice President PCIM Europe	784

Titelbild

*Mit ihrem Fertigungsstandort in Berlin steht die CONTAG AG



für Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Innovation in der Leiterplatten-Prototypenfertigung. In mehr als 40 Jahren hat sich die familiengeführte CONTAG AG kontinuierlich zu einem der führenden europäischen Produktionsbetriebe von Leiterplatten und Prototypen entwickelt. Die Ergebnisse aus Forschungsprojekten fließen direkt in die Produkte ein. Neben den Standardprodukten Multilayer bis zu 24 Lagen, Starrflex-Leiterplatten und IMS-Platinen umfasst das Produktportfolio Innovationen wie dehnbare oder 3D -MIDLeiterplatten*

www.contag.de

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Elektronik-Design e. V. Tel. +49 30 340 60 30 50 691 info@fed.de, www.fed.de



EIPC - Der Europäische Elektronik-Verband Tel. +31 46 4264258 www.eipc.org

700



Fachverband Flectronic Components and Systems electrifying Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

713



Fachverband PCB and Electronic Systems Tel. +49 69 6302-437 PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL **MICROELECTRONICS** AND PACKAGING SOCIETY -Deutschland e. V. 728 Tel. +49 3677 69-3381 martin.schneider-ramelow@imaps.de www.imaps.de



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V. Tel. +49 911 5302-9100 info@3dmid.de. www.3dmid.de

735



DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. Tel. +49 211 1591-0 romina.krieg@dvs-hg.de www.dvs-ev.de

740